

台灣上、中、下游電子廠商全力搶進

# 中低階智慧型手機商機大爆發

在智慧型手機朝向M型化發展之際，低價智慧型手機市場商機正全面湧現，尤其龐大的中國大陸商機更是可觀。在國際大廠紛紛搶進之際，台灣供應鏈廠商也都已經進駐，期望在激烈的中國大陸低價智慧型手機市場中殺出重圍，分得一杯羹。

◎撰文／劉麗惠 圖片提供／達志影像

隨著資訊科技的發達，在智慧化與行動化訴求下，各種電子終端產品中以智慧型手機市場的成長動能最為強勁。

根據拓璞產業研究所的報告顯示，2012年全球手機市場出貨量將達到17.8億支，其中智慧型手機出貨量預估達到6.8億

支，較2010年的4.5億支大幅成長51.1%。且依拓璞預估，未來成長速度仍非常強勁，2013年全球智慧型手機出貨量將達到8.6億支，年成長率高達26.5%，滲透率攀上46.2%，預估到2015年全球半數手機將為智慧型手機的天下。

快速起飛的智慧型手機市場

商機何在？拓璞產業研究所通訊中心經理謝雨珊強調，未來智慧型手機將朝向M型化趨勢發展，高階機種將進行激烈的硬體規格戰，而低階機種將呈現出高規格、低價格的競爭趨勢。工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）也指出，未來3年智慧型手機仍將



小米科技所推出的「小米機」在中國大陸以低價、高規格闖出名號，極具競爭力，令中低階智慧型手機，市場陷入激戰。

是市場的成長主力，其中高階智慧型手機比重仍然最高，而低階智慧手機出貨量在新興市場的需求湧現，將呈現大爆發的狀態。

## 中低階智慧型手機商機引爆4大因素

2013年中低階智慧型手機市場不容小覷，拓璞產業研究所副所長楊勝帆指出，中低階智慧型手機市場呈現快速走揚的態勢，從產業面、產品面與應用面深入分析，主要基於以下4大因素。

### 因素1：Android平台降低門檻

在Google推出Android智慧型手機平台之後，大幅降低業者進入智慧型手機市場的門檻。NPD DisplaySearch研究總監李昕霖指出，Android系統是開放式資源，也是低成本智慧手機設計主要操作系統；同時，低成本解決方案較高階智慧手機的生產週期更短，並可透過現成的解決方案，由應用處理器廠商進行生產。

也就是說，Android平台讓推出智慧型手機不再是蘋果電腦（Apple）、三星（Samsung）等品牌大廠的專利，包括中國大陸的中興、華為、酷派，以及台灣由技嘉科技100%轉投資的集嘉通訊，都紛紛推出採用Android平台的低價手機。

### 因素2：3G到位驅動新興市場買氣

除了平台業者Google與手機製造商的投入因素，電信營運商



智慧型手機市場朝向M型化發展，雖然高階機種仍為市場主力，但中低階產品因價格相對較低，符合消費者需求，商機開始大量湧現。

的助攻也不可少，IEK指出，近年來，新興市場電信營運商積極將行動通訊網路從2G轉到3G，基礎網路建設到位，讓原本使用功能性（Feature Phone）手機的消費者，開始想要轉用智慧型手機，享受網路的便利。然而，由於新興市場消費者的預算有限，沒有能力購買高階智慧型手機，首要考量就是購買中低階機種。

「由於未來新興市場是帶動智慧型手機成長的關鍵力道，而在當地消費者以採購中低階機種為主之下，將促成中低階智慧型手機市場的出貨量快速成長。」謝雨珊分析，過去北美與西歐是最大的智慧型手機市場，但是近年來亞太地區的手機使用者滲透率與日俱增，尤其擁有14億龐大人口數的中國大陸，手機滲透率已經在2012年第2季突破57.5%，成為全球最大智慧型手機市場，

同時也是中低階智慧型手機出貨量最大的國家。

### 因素3：公板晶片壓低手機價格

在產品與基礎網路建設都到位之下，想拓展市場，最重要的環節就是產品售價讓消費者能接受，而手機晶片大廠陸續跨足中低階智慧型手機晶片開發，則促成中低階智慧型手機在硬體性能提升的同時，價格持續降低，成為驅動市場成長的最關鍵力道。

謝雨珊指出，隨著高通、聯發科與海思等IC設計大廠紛紛推出智慧型手機統包（Turnkey）方案，大幅改善手機製造商與設計廠商在系統整合的問題，因而縮短智慧型手機開發時程，並使手機元件（BOM）成本降低，進而壓低整體手機價格。此外，隨著博通（Broadcom）與ST-Ericsson、德儀（TI）等晶片大廠積極規畫低價手機解決方案，即



以功能性手機的公板模式搶食低階市場機種，中低階智慧型手機價格將可壓低到100美元以下。

根據拓璞的最新報告顯示，2012年中國大陸智慧型手機市場預估達到1.69億支，而價格在人民幣1,500元以下的中低價智慧型手機約占60%，謝雨珊強調，中國大陸智慧型手機銷售量保持高成長的關鍵因素，在於價格的總體下調，促使大量中等收入族群紛紛選擇換用低階智慧型手機。

#### 因素4：電信商增加採購低階機種

在產品、網路環境與價格元素都齊備之後，促使中低階智慧型手機出貨量快速起飛的臨門一腳，就是通路的全力支持。做為手機通路商的電信營運業者，基於高階智慧型機種需要高額手機補貼才能拉抬銷售，因此，為了降低手機補貼額，電信營運商莫不積極推銷中低階機種。

謝雨珊表示，中低階智慧型手機讓電信營運商不用花錢補貼，而能實現更多電信用戶使用手機上網的功能，進而大幅增加電信業者的每用戶平均收入（Average Revenue Per User）。因此，從2012年末到2013年，可以預見電信營運商都將持續增加採購中低階智慧型手機。

## 龐大內需 全球廠商激戰中國

在全球中低階智慧型手機



在全球中低階智慧型手機市場中，擁有13億人口的中國大陸，內需商機最為龐大。

市場中，又以中國大陸的商機最為龐大。根據拓璞產業研究所預估，2013年中國大陸智慧手機市場滲透率將達61%，遠高於全球智慧手機市場滲透率的平均水準46.2%，而2013年中國大陸智慧手機市場出貨量將達2.56億支，其中具備優質、平價條件的中低階智慧型手機市場潛力可期。

「超低價智慧型手機的時代已經來臨，」拓璞產業研究所上海子公司研究經理謝醫軍指出，2012年中國大陸智慧手機市場主推價人民幣1,000元（約新台幣4,700元）的機種，2013年又將出現售價100美元的機種（約新台幣2,900元），人民幣1,000元的機種滲透率也將從2012年的18%增長到2013年24%。

面對中國大陸龐大的中低階智慧型手機商機，台灣上、中、下游廠商無不思考如何搶攻市

場，然而，儘管台灣擁有完整中低階智慧型手機供應鏈，但面對中國大陸競爭激烈的市場，上、中、下游都有一場苦戰要打。

#### 下游：品牌廠面臨中國大陸價格戰

儘管中低階智慧型手機商機龐大，但因競爭相當激烈，要分得市場一杯羹，勢必有一番辛苦的纏鬥。拓璞產業研究所研究經理李永健表示，尤其在以小米機為代表的中國本土手機廠商發動價格戰之後，其他廠商也跟進採取價格競爭策略，因此中低階智慧型手機市場已進入激烈的價格廝殺戰。

謝醫軍指出，中興、華為、酷派與聯想等中國大陸智慧手機4大手機廠，無不積極透過人民幣1,000元智慧型手機快速占領中低階市場，增加其在3G手機市場的滲透率，因此，台灣品牌廠商宏達電（HTC）要成功搶攻市場，

得面臨上有三星、下有中國大陸廠商的雙重夾殺，想突破重圍，恐怕沒那麼容易。台灣必須推出更具價格競爭力的產品與深化在地化聯盟，才有機會突破重圍。

有鑑於此，將今年訂為「手機調整年」的宏碁，在將中國大陸視為中低階智慧型手機市場首要戰場之後，其入門智慧型機種 Z110，定價僅港幣1,000元，而在策略聯盟方面，宏碁計畫與阿里巴巴合作，推出名為「阿里雲」的手機，不過，日前卻發生計畫臨時取消的狀況，但宏碁對此表示，雙方未來仍會繼續合作。

#### 上游：IC設計廠 競逐高規格、低價格產品

除了品牌廠，在中低階智慧型手機市場競爭最為激烈者，非IC設計廠商莫屬。包括基頻晶片廠商聯發科，及驅動IC業者奕力、聯詠、旭曜、旭創都積極布局市場，義隆也將搶進。

在基頻晶片競爭上，李永健分析，面對中國大陸手機產業的「高規格、低價格」趨勢，國際與中國大陸本土手機晶片大廠高通（Qualcomm）、聯發科、展訊、銳迪科（RDA）等，皆紛紛加強發展高規格、低價格的晶片解決方案。

目前高通、聯發科都已推出針對智慧型手機的公板解決方案，其中，高通祭出高通參考設計（QRD，Qualcomm Reference

Design）生態系統計畫；至於藉由中國大陸中低階智慧型手機市場再突破重圍的聯發科，已經發展出雙核心處理器的晶片解決方案，準備瞄準人民幣800~1200元的中低價智慧型手機市場。

中國大陸IC設計大廠——展訊也加強火力攻占3G智慧型手機晶片市場，該公司提供支援「雙卡雙待」的基頻晶片，以便博取消費者的青睞；至於收購基頻公司Coolsand的銳迪科，正全面強化其產品線與技術能力，預計在2013年全力搶進中低階3G智慧型手機市場。

至於驅動IC業者積極透過規畫中低階產品搶進市場，義隆電子董事長葉儀皓指出，從2011年第3季中國中低階手機市場就快速起飛，今年的成長也不容小覷，有鑑於此，義隆也將全面布局中國低價手機市場，初步將先尋求切入二線品牌廠的機會，而策略上，將如發展其他產品一樣，在低價手機市場將強化與下游客戶的合作，提供完整解決方案。

#### 中游：組裝、零組件廠 以成本控制奮力搶單

在組裝代工廠部分，目前包括富士康、英華達、華寶、華冠等業者都已經切入低階智慧型手機市場。謝雨珊認為，中低階智慧型手機利潤微薄，再加上品牌廠不斷將成本壓力加在零組件供應商與組裝業者身上，因此，台



為搶食中低階智慧手機，全球晶片大廠紛紛開發高規格、低價格的晶片解決方案。

灣代工廠可以利用原有的成本控制能力，爭取到品牌廠的訂單。

由於中低階智慧手機市場的價格戰，導致所有手機品牌廠的獲利降低，因此，若想提高獲利，手機品牌廠勢必會將成本轉嫁到零組件端，將對零組件供應商帶來衝擊。有鑑於此，零組件廠在布局此市場時，必須掌握價格與規格，以求控制成本。李昕霖分析，品牌廠為了維持低價，要求零件必須成本低廉以及供應量充足，台廠應該對這兩點有所掌握，才有機會搶得訂單。

總而言之，台廠在搶攻全球低價智慧型手機市場時，同時面對中國大陸本土供應鏈日趨完備的競爭，以及韓廠三星以垂直整合之姿的攻城略地。台灣上、中、下游電子廠商應該積極透過各種策略應用，包括加強自身在成本控制、縮短交期等方面進行改善，才有機會滿足品牌廠商的低價格、高規格要求，順利取得市場商機。■